

기술분석보고서 IT

다원넥스뷰(323350)



작성기관 한국기술신용평가(주) 작성자 김명호 전문연구원

[▶ YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미공개 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-525-7759)로 연락하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

다원넥스뷰(323350)

초정밀 마이크로 접합 기술 기반 반도체 후공정 턴키 플랫폼 선도기업

기업정보(2025.08.21 기준)

대표자	남기중
설립일자	2009.11.20
상장일자	2024.06.11
기업규모	중소기업
업종분류	반도체 제조용 기계 제조업
주요제품	LSMB 기반 통합 턴키 플랫폼, 솔더볼 제팅 기반 마이크로 리페어 장비

시세정보(2025.08.21)

현재가(원)	6,900
액면가(원)	100
시가총액(억 원)	553
발행주식수(주)	8,010,772
52주 최고가(원)	8,970
52주 최저가(원)	4,050
외국인지분율(%)	3.17
주요주주(%)	
다원시스	23.1
남기중 외 2인	15.6

■ 마이크로 접합 기반 반도체 테스트·패키징 턴키 장비 포트폴리오

다원넥스뷰(이하 ‘동사’)는 레이저 기반 초정밀 마이크로 접합(Laser Systemic Micro-Bonding Technology, 이하 ‘LSMB’) 기술로 pLSMB(프로브 카드 전 공정 턴키)·sLSMB(솔더볼 제팅 기반 마이크로 리페어)·dLSMB(FMM 리페어·태양광 스크라이빙) 장비를 자체 개발·제조한다. 대표 기술제품 분야는 pLSMB의 본딩·절단·삽입·검사·리페어, sLSMB의 Laser Bump Mounter·Solder Ball Jet(40~80 μ m), dLSMB의 FMM 리페어·대면적 박막 가공으로 구성되며, 래시피 모듈화·인라인 옵션과 CIM/SECS·GEM 연동으로 테스트-패키징-소재 가공까지 턴키로 제공한다.

■ 후공정 장비 및 SATS 수요 확대에 따른 적용 영역 확장

동사의 핵심 목표시장은 반도체 후공정 장비(패키징·테스트)와 SATS(반도체 조립, 테스트 및 후공정 서비스)다. 동사는 pLSMB로 프로브 카드 제작·검사·리페어 턴키를, sLSMB로 FC-BGA·WLP/FO·SiP 등 고급 패키징의 마이크로 범프 형성·리페어를 직접 공략한다. 고객은 기관사·OSAT·IDM이며, 국내는 직판·해외는 직판+대리점 병행, ‘샘플→파일럿→양산’ 모델로 반복 수주를 확대한다.

■ 중국·일본 중심 글로벌 진출과 현지화 서비스 체계 고도화

동사는 중국·베트남을 1차, 일본·대만·태국을 2차 시장으로 목표하여 수출을 확대할 예정이다. 중국 시장은 SUMEC-ITC 협력으로 pLSMB 레퍼런스를 확대하고 일본 시장은 sLSMB(솔더볼 제팅/리페어)로 고집적 패키징을 공략하며, dLSMB는 태양광 스크라이빙·FMM 리페어 응용을 병행하고 있다. 현지 대응은 서비스 사무소→법인→브랜치로 단계를 확대하고 데모 장비·클린룸 증설을 검토하며, 래시피 표준화 등을 통해 생산속도 향상 및 운영비 절감을 실현하여 레퍼런스·반복 수주를 늘리고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 개별 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2022	110	-12.5	8	7.0	99	90.3	-169.7	103.17	-172.9	1,370	-2,003	7.9	-5.4
2023	107	-3.1	-6	-6.0	1	0.8	-1.6	0.6	346.4	12	498	825.3	20.1
2024	187	75.5	13	6.8	-41	-22.1	-43.4	-18.4	82.9	-541	1,913	N/A	2.6

기업경쟁력

LSMB 통합 턴키 플랫폼	- pLSMB, sLSMB, dLSMB를 라인-레시피 단위로 통합하여 반도체 테스트-패키징-디스플레이/태양광 소재 가공까지 전 공정을 일괄 제안하는 시스템을 구축
특허·핵심역량 내재화	- 레이저·광학 기술, 초정밀 스테이지 제어·보정, 3차원 비전, 자동보정 로직을 자체 보유하며, '프로브 본딩장치 및 방법'·'솔더링(솔더볼 제팅) 장치' 등 등록특허를 통해 기술 장벽과 품질·생산성 경쟁력 확보

핵심 기술 및 적용제품

pLSMB (프로브 카드 턴키)	- 다중 비전 기반 높이 산정/자동 Z보정·재하강 제어로 본딩 정밀도·수율을 극대화한 본딩-절단-삽입-검사-리페어 일괄 솔루션	pLSMB 
sLSMB (솔더볼 제팅/범핑)	- 디스크 피더+가스/압력 연동+틸팅 노즐로 40~80μm 마이크로 범프 형성·리페어를 고속·고정밀로 수행	sLSMB 
dLSMB (디스플레이/태양광 응용)	- FMM 리페어와 대면적 박막 스크라이빙·커팅으로 반도체 외 연관 공정까지 포트폴리오 확장	

시장경쟁력

적용 시장 확대	- FOWLP-2.5D/3D-SiP 확산과 품질·신뢰성 강화 흐름 속 후공정·SATS 투자 증가를 직격하는 제품 라인업
APAC 레퍼런스 및 현지화	- 중국·베트남을 축으로 대만·일본까지 직판+대리점·서비스 거점(사무소→법인→브랜치)로 영업 - A/S 대응력 강화
고객 락인·생산성 패키지	- '샘플→파일럿→양산' 반복수주 모델과 인라인화·레시피 표준화·CIM/SECS-GEM 연계로 TACT·TCO를 실질 개선

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E 환경경영	◎ 동사는 친환경 Flux-Free 공정 기술 도입으로 화학물질 사용을 최소화하고 공정을 단순화하고 있음. ◎ 동사는 환경 법규 위반·환경 관련 사고에 대한 기록이 없어 일정 수준 이상의 환경경영 관련 위배사항에 해당되는 항목이 없는 것으로 보임.
S 사회책임경영	◎ 동사는 임직원에게 사외교육/사내강의, 학자금 지원, 건강검진 비용 지원 등의 다양한 복지제도를 운영하고 있음. ◎ IR 활동이 상장법인의 경영 책무임을 인식하고 있으며, 투자 관계자와의 신뢰 관계를 구축하고 있고, 관련 자료를 거래소 공시 제출 시스템에 게재하고 있음.
G 기업지배구조	◎ 이사회 운영규정 및 주요 내용을 일반투자자들이 이해할 수 있도록 전자공시시스템 내 분기보고서 등에 주요 의결사항 및 활동내역 등을 첨부하여 공개하고 있음. ◎ 동사는 공정한 기업활동을 위한 윤리헌장을 마련하고 있고, 감사실을 운영하고 있음.

I. 기업 현황

레이저 기술 기반의 반도체 등 초정밀 공정장비 제조 전문기업

동사는 LSMB 기술력을 기반으로 반도체, 디스플레이 및 스마트폰 등 산업에서 응용된 레이저 본딩, 솔더링, 용접 등 레이저 접합 공정 장비를 제조·판매하고 있다. 그리고 동사는 레이저 텍스처링, 에칭, 마킹, 커팅, 스크라이빙 등 레이저 정밀 가공 장비의 생산 및 판매를 영위하고 있다.

■ 회사의 개요

동사는 반도체 등 산업용 레이저장비 제조 및 판매를 목적으로 2009년 11월 20일에 설립되었다. 반도체 테스트 및 패키징 공정에 필요한 공정 장비 및 기기 등을 주력 제품으로 사업을 확대 성장시켜 나가고 있는 기업으로서 반도체 제조업을 가장 중요한 전방산업으로 두고 있으며, 양산 제조에 필요한 자동화 장비를 첨단 레이저 공정 기술을 솔루션으로 응용하여 개발 및 제조하고 있다. 동사의 본사는 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485에 소재하고 있다.

동사는 코스닥 시장 상장을 위하여 신한제9호기업인수목적 주식회사와 2024년 5월 27일 합병기일로 하여 합병을 완료하였으며, 2024년 6월 11일 코스닥 시장에 상장 하였다.

동사는 반도체 테스트 공정장비를 주력 분야로 하고, 주 제품은 Probe Laser Systemic Micro-Bonding 제품군이며, 반도체 패키징 공정과 디스플레이 산업 공정장비 등 제품군을 단계적으로 개발하여 사업 영역 확대와 함께 미래 경쟁력 확보에 매진하고 있다.

표 1. 동사 주요 연혁

일자	연혁 내용
2009.11	(주)넥스뷰티엑스 법인 설립
2010.06	Laser Texturing 제품 개발 및 납품(레이저 정밀 가공 시장 진입)
2011.05	부설연구소 설립
2014.11	(주)다원시스 자회사로 편입
2014.11	Laser Micro-Bonding 기술 개발(반도체 테스트 시장 진입)
2015.09	레이저 정밀 가공 장비 삼성전기, LG전자납품
2015.11	Wafer MEMS Probe Card용 본딩 장비 납품 업체 양산 성공
2018.04	Laser Micro-Solder Ball Jetting 기술 개발(반도체 패키징 시장 진입)
2019.05	코넥스 상장
2022.11	Laser Micro-Bonding System 장영실상 수상
2022.12	차세대 Laser Micro-Bonding 장비 납품(국내 최초 DRAM용 High Speed Bonder)
2023.04	소재,부품,장비 전문기업확인서 인증
2023.11	세계일류상품인증(Laser Micro-Bonding System)
2024.06	코스닥시장 이전상장
2024.12	제61회 무역의 날 시상 中 '3백만불 수출의 탑' 수상

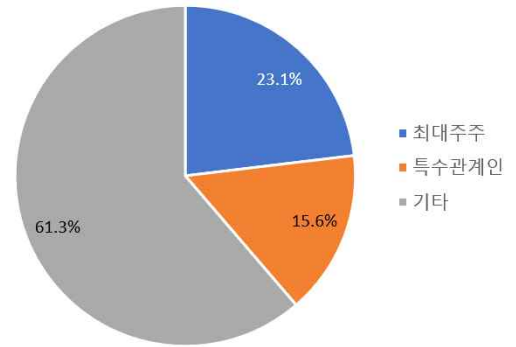
자료: 동사 사업보고서(2024.12.) 및 홈페이지, 한국기술신용평가(주) 재구성

동사의 최대주주는 (주)다원시스로 23.1%를 보유하고 있으며, 남기중 대표이사 외 임원 2인이 15.6%를 보유하고 있다.

표 2. 동사 지분구조 현황

주주명	관계	주식수(주)	지분율(%)
다원시스	최대주주	1,850,000	23.1
남기중 외 2인	특수관계인 (대표이사, 임원)	1,250,000	15.6
기타	기타	4,910,772	61.3
합계		8,010,772	100.0

그림 1. 동사 지분구조 현황



자료: 동사 반기보고서(2025.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

자료: 동사 반기보고서(2025.06.)

■ 대표이사

남기중 대표이사는 1965년생으로 연세대학교 물리학과에서 학사, 석사 및 박사학위를 취득하였으며, 미국 에모리대학교에서 Post-Doctoral Researcher으로 활동하였다. 대표이사는 1996년 7월 고등기술연구원에 합류하였으며, 2007년 3월까지 레이저 응용 기술센터장으로 재직하였다. 이후 제이스텍으로 이직하여 2010년 6월까지 CTO 및 사업본부장을 역임하였으며, 2009년 동사를 창업하고 2010년 7월부터는 동사의 대표이사직을 수행하고 있다.

남기중 대표이사는 15년 이상 반도체 레이저 분야에서의 전문성과 HBM, FC-BGA 등 첨단 반도체 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 '2024 벤처창업진흥 유공 포상' 시상식에서 산업포장을 수상하였다. 또한, 2023년에는 세계일류상품 인증을 수상하였다.

■ 주요 사업 분야

동사는 사업 초기부터 레이저를 이용하여 반도체 및 스마트폰 부품 등 초소형 제품의 Soldering, Bonding 공정을 수행하는 레이저 마이크로 접합(Laser Micro-Joining)분야와 마이크로 가공(Laser Micro-Machining)분야에 집중하여 'LSMB(Laser Systemic Micro-Bonding)'이라는 특화된 기술로 제품화에 성공하였다. 이를 기반으로 레이저 솔더링 장비, 레이저 마이크로 본딩 장비 등이 본격 양산·판매되기 시작하였으며, 레이저 광학 및 응용 기술, 초정밀 Stage 모션 제어 기술 및 보정 기술 등의 완성도를 확보하였다.

동사는 축적된 레이저 기술력을 바탕으로 반도체 테스트 공정에 필요한 pLSMB(Probe Laser Systemic Micro-Bonding)제품군과 반도체 패키징 공정에서 필요한 sLSMB(Solder Ball Laser Systemic Micro-Bonding)제품군을 단계적으로 개발·양산하였다.

또한, 사업 확대를 위해 dLSMB(Display Laser Systemic Micro-Bonding)제품군을 개발하여 미래 경쟁력 확보에 매진하고 있다.

■ 제품군별 매출실적

반도체 및 디스플레이 산업용 장비를 납품하고 있는 동사는 연도별 매출실적 변동성이 매우 높은 특징을 보이고 있다. 동사의 주력 사업은 반도체 테스트 공정 장비 pLSMB 제품군으로 2023년과 2024년 매출액은 각각 58억 원과 121억 원으로 전기 대비 각각 (-)33.7%와 113.6% 성장하였으며, 2024년 기준 매출액 비중은 65.0%이다. 2025년 상반기 pLSMB 제품군 매출실적은 59억 원으로 전체 매출액의 67.9%를 차지하고 있다.

동사의 차세대 주력 제품군인 반도체 패키징 장비 sLSMB는 2023년과 2024년에 각각 26억 원과 28억 원의 매출을 달성하였으며, 전기 대비 각각 1,349.5%와 6.5%의 성장률을 시현하였다. sLSMB 제품군은 2024년 기준 전체 매출액의 15.0%의 비중까지 확대되었으나, 2025년 상반기에는 일시적으로 매출이 6억 원까지 감소하였다.

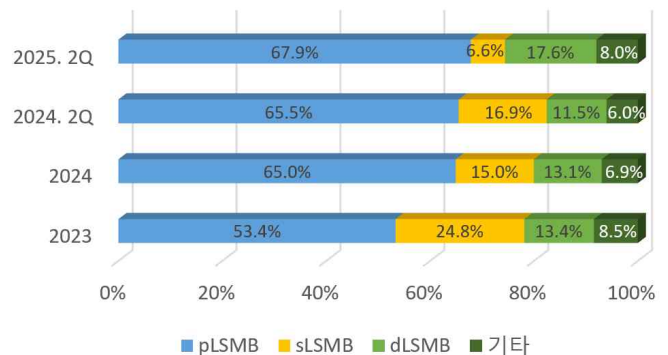
동사의 dLSMB 매출액은 2023년과 2024년 각각 14억 원과 25억 원으로 전기 대비 (-)6.7% 및 71.2% 성장하였으며, 2025년 상반기에는 15억 원의 매출을 달성하였다.

동사의 기타매출액은 Parts(부품)와 용역매출로 매년 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2024년 기타품목은 13억 원의 매출이 발생하였으며, 2025년 상반기에는 7억 원의 매출을 기록하였다.

표 4. 제품군별 매출실적 (단위: 억 원, K-IFRS 개별 기준)

품목군	2023	2024	2024. 2Q	2025. 2Q
pLSMB	58	121	56	59
sLSMB	26	28	15	6
dLSMB	14	25	10	15
기타	9	13	5	7
합계	107	187	86	87

그림 2. 제품군별 매출비중 (단위: % K-IFRS 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.)

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.)

II. 시장 동향

후공정 장비 및 SATS 시장: 미세화·첨단패키징 수요와 APAC CAPEX가 이끄는 성장 시장

동사의 주요 타깃 시장은 반도체 후공정 장비와 SATS로, 고집적·미세화와 FOWLP·2.5D/3D·SiP 확산에 따라 정밀·고속·자동화 장비 및 외주 조립·테스트 수요가 동반 확대되는 분야다. 최근 AI·HPC 수요와 전동화·5G 확산, APAC CAPEX 증가로 pLSMB·sLSMB 중심의 수요가 강화되며 중장기적으로도 안정적 성장이 전망된다.

■ 목표시장: 반도체 후공정 장비 및 SATS

다원넥스뷰의 핵심 목표시장은 (1) 반도체 후공정 장비 시장과 (2) SATS 서비스 시장이다. 후공정 장비는 웨이퍼 가공 이후의 패키징 장비(본딩·범핑·어셈블리)와 테스트 장비(전기적 성능·신뢰성 평가)를 포괄하며, 이 시장은 고집적·미세화, FOWLP·2.5D/3D·SiP 등 고급 패키징 확산과 품질/신뢰성 요구 강화로 정밀·고속·자동화 장비 수요가 동반 확대되는 것이 특징이다. SATS 시장은 반도체 조립 및 테스트 서비스를 아웃소싱하는 시장으로, 팹·팹리스/IDM의 어셈블리·테스트 아웃소싱 수요로 형성되며, 수요는 전자·자동차(전동화/자율주행)·통신(5G)·산업용·의료 등으로 다변화되고 있다.

동사는 pLSMB(프로브 레이저 마이크로 본딩)로 테스트 공정용 프로브 카드 제작·검사·리페어 턴키 수요를, sLSMB(솔더볼 레이저 채팅/범핑)로 고급 패키징(FC-BGA, WLP/FO, SiP 등)의 마이크로 범프(약 40~80 μ m) 형성·리페어 수요를 직접 타깃하고 있다. 고객군은 기판 제조사, OSAT, IDM으로 구성되며, 중국·일본·대만·베트남 등 APAC 수출이 병행되고 있으며, 국내는 직판 중심인 것으로 파악된다.

표 4. 글로벌 스마트 제조 시장 분석

구분	내용
촉진요인	- 고급 패키징 확산(FOWLP, 2.5D/3D, SiP)으로 범핑/본딩 정밀화 요구 증가 - 소형화·고성능화와 품질/신뢰성 강화로 테스트·리페어 장비 투자 확대 - 5G·클라우드·IoT 및 전기차/자율주행 확대에 APAC 중심 수요 증대 - SATS의 CAPEX 확대 및 아웃소싱 심화로 패키징·테스트 설비 교체 수요 증가
저해요인	- 고가 CAPEX와 장비 퀄리피케이션(인증) 리드타임 부담 - 공정 복잡도 상승에 따른 기술인력/레시피·공정 데이터 확보 난이도 - 거시 변수(환율·수요 사이클)에 따른 투자 변동성
시사점	- 동사는 pLSMB(테스트·프로브 카드 턴키)와 sLSMB(마이크로 범프·리페어)로 후공정 장비 수요와 SATS 투자 흐름을 동시에 타깃팅 - APAC 직판+대리점 병행으로 중국·일본·대만·베트남 등 핵심 권역 공략 강화, 샘플 테스트-양산 반복 수주 체계로 고객 락인 - CIM·SECS/GEM, 레시피 기반 모듈화/인라인 옵션, 고속 본딩/3D 측정 등 공장 연동·생산성 패키지로 TCO·TACT 개선 제안

자료: Valuates Reports "Global Semiconductor Back-End Process Equipment Market Research Report 2024"(2024.11), Fortune Business Insights "Semiconductor Assembly and Test Services (SATS) Market Size, Share..."(2025.07), 한국기술신용평가(주) 재구성

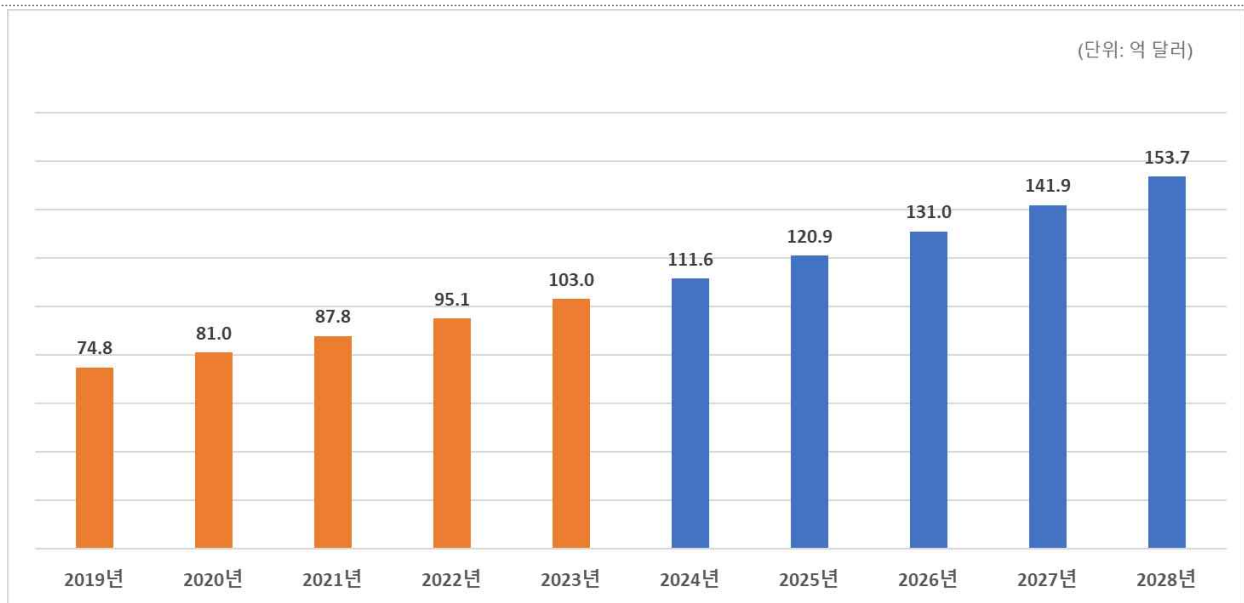
■ 목표시장 규모 및 경쟁사

동사의 목표시장은 반도체 후공정 장비(패키징·테스트 장비)와 SATS(반도체 조립·테스트 아웃소싱 서비스)이다.

2024년 11월 Valuates Reports의 자료에 의하면, 후공정 장비 시장은 2023년 103.0억 달러에서 연평균 8.3%씩 성장하여 2028년 153.7억 달러에 다다를 것으로 전망된다. 해당 시장은 패키징 장비(본딩·범핑·어셈블리)와 테스트 장비(성능·신뢰성 검증)를 포괄하며, FOWLP·2.5D/3D·SiP 등 고급 패키징 확산과 고집적·미세화 트렌드가 장비의 정밀·고속·자동화 수요를 견인하는 것으로 확인된다.

후공정 장비(패키징·테스트) 시장 내 주요 경쟁사로는 Advantest, Teradyne, Cohu(구 Xcerra·MCT 포함), Tokyo Seimitsu(ACCRETECH), Tokyo Electron, Changchuan Technology, Beijing Huafeng, Hon Precision, Semics, Tianjin JHT Design 등이 검사·계측·본딩·어셈블리 전반에서 확인된다.

그림 3. 세계 후공정 장비 시장 규모 및 전망

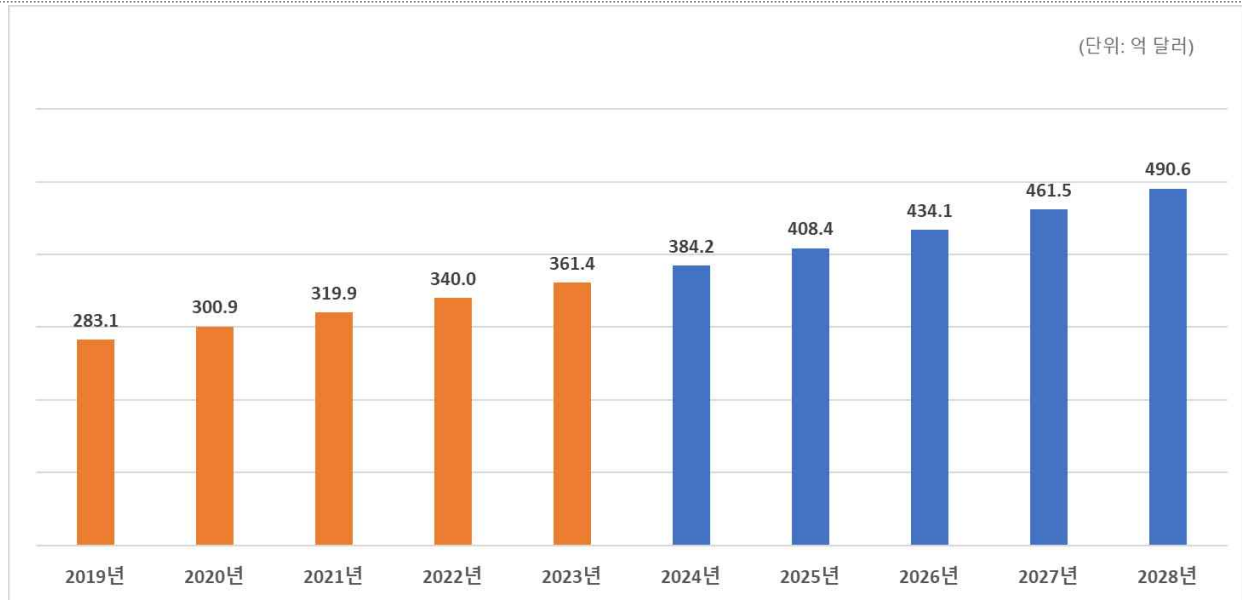


자료: Valuates Reports “Global Semiconductor Back-End Process Equipment Market Research Report 2024”(2024.11), 한국기술신용평가(주) 재구성

2024년 3월 Fortune Market Insights의 자료에 의하면, SATS 시장은 2023년 361.4억 달러에서 연평균 6.3%씩 성장하여 2028년 490.6억 달러에 이를 것으로 전망되며, 아시아태평양(APAC)이 최대 비중을 차지(예: 2020년 46% 수준)하고, 소비자전자·자동차 전동화·5G 통신·산업용 등에서 수요가 확대될 것으로 전망된다. 동사는 이 중 테스트(프로브카드 제작·검사·리페어)와 고급 패키징(마이크로 범프 형성·리페어) 장비로 시장을 공략하고 있는 것으로 파악된다.

OSAT/SATS 시장 내 주요 경쟁사로는 ASE Group, Amkor Technology, SPIL(실리콘웨어), PTI, JCET Group, ChipMOS, UTAC, Chipbond 등이 확인된다. APAC 집중과 첨단 패키징 투자 확대가 향후 경쟁정도를 제고시킬 것으로 판단된다.

그림 4. 세계 SATS 시장 규모 및 전망



자료: Future Market Insights "Semiconductor Assembly and Testing Service Market Outlook..."(2024.03), 한국기술신용평가(주) 재구성

III. 기술분석

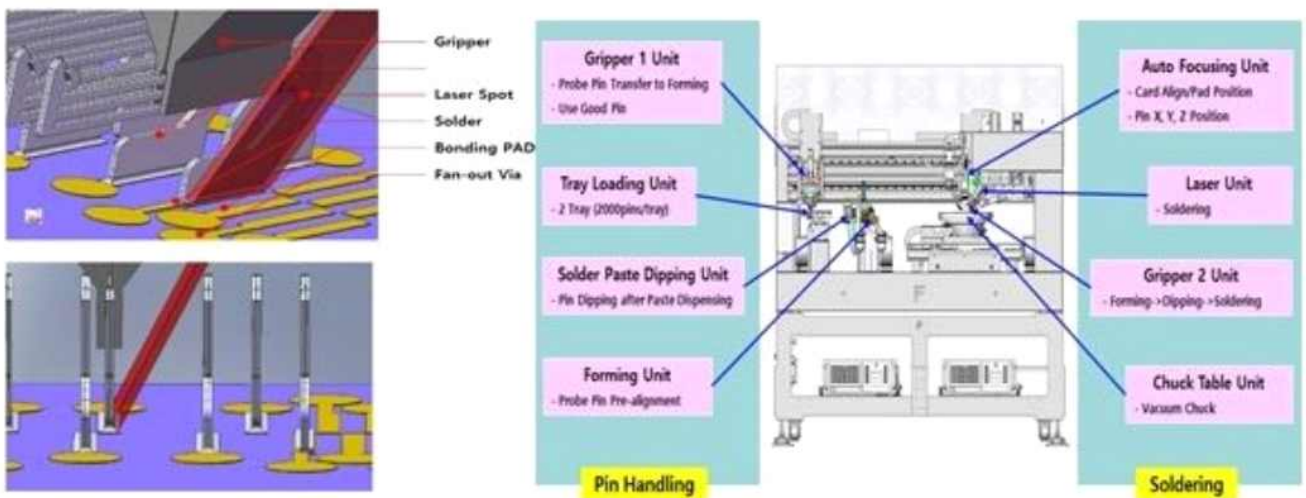
LSMB 턴키 플랫폼과 현지화 영업으로 글로벌 수주 확대

동사는 LSMB 기반 장비 전문기업으로 반도체 테스트·패키징, 디스플레이/태양광 공정을 턴키(일괄) 공급한다. 또한 고속 본더, 인라인화, 3D 측정, CIM/SECS-GEM 등의 자동화 핵심 인프라 기술을 기반으로 고정밀화와 동시에 생산성을 높이고 있다.

■ LSMB 통합 플랫폼: p/s/d로 테스트, 패키징, 소개 가공까지 턴키화

동사는 LSMB 자동화 장비를 자체 개발·제조하며 반도체·디스플레이 전방 공정에 쓰이는 핵심 솔루션을 보유하고 있다. 웨이퍼 레벨 테스트용 프로브 카드 집합 pLSMB, 패키지/기판 마이크로 솔더 범프 형성·수리 sLSMB를 축으로 레이저 빔 조형, 초정밀 스테이지 제어·보정, 3차원 비전, 양산 자동화 기술을 내재화했고, ‘프로브 본딩장치 및 방법’과 ‘솔더링(솔더볼 제팅) 장치’ 등 특허로 공정 정밀도와 생산성에서 기술 장벽을 구축하고 있다.

그림 5. 공정 및 장비 개념도



자료: 동사 분기보고서(2025.05)

동사는 pLSMB·sLSMB·dLSMB(Display LSMB) 제품군으로 테스트와 패키징 전 공정을 턴키로 대응하고 있다. pLSMB는 프로브 본딩·절단·삽입·검사·리페어를 통합 공급하고, sLSMB는 레이저 솔더볼 제팅·Bump Mounter 등 고집적 기판 대응 장비로, dLSMB는 디스플레이/태양광 응용 장비로 포트폴리오를 구성한다. 매출은 pLSMB·dLSMB가 주축이며 국내 직판과 중국·일본·대만·베트남 등 수출을 병행하고 고객군을 기판사, OSAT, IDM으로 확대 중이다.

pLSMB는 다중 비전 기반 높이 산정·자동 보정과 단계적 하강/재하강 로직을 레이저 본딩에 적용해 정밀도·수율을 높였다. sLSMB는 디스크형 안착홈 피더, 검출센서, 가스 가압, 압력센서, 틸팅 노즐을 결합한 구조로 노즐 내 용융→분사 일체 공정을 구현해 약 40~80 μ m급 마이크로 범프 형성·리페어를 고속·고정밀로 수행한다. dLSMB는 FMM 리페어와 태양광 스크라이빙 등 응용 공정을 확대 중이다.

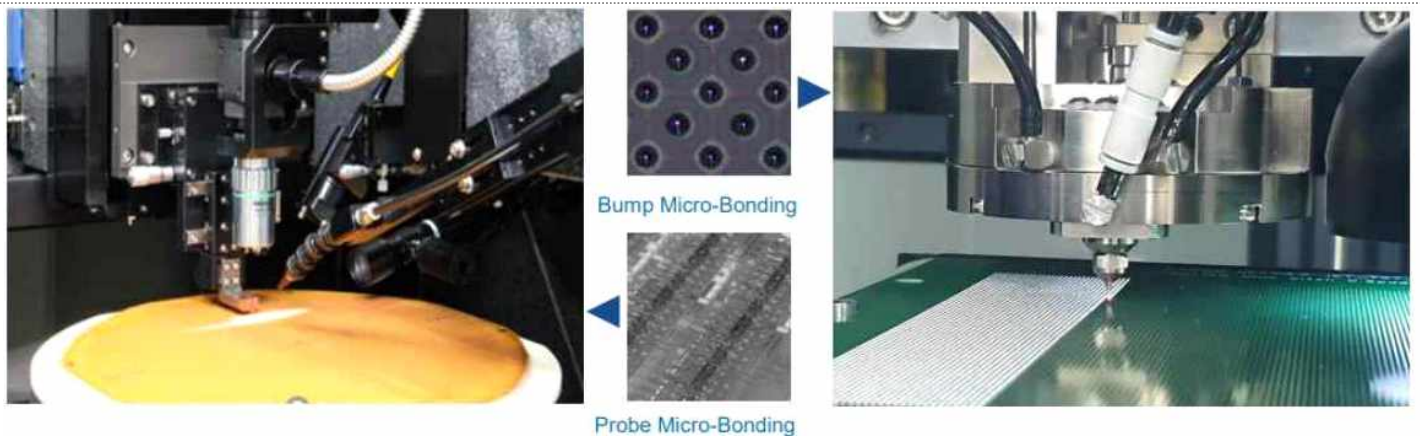
연구개발은 pLSMB 고속 본더·리페어 장비의 적용 영역 확대와 3차원 측정, 인라인화, Vertical Pin Inserter 등 기능 고도화에 집중하고 있다. sLSMB는 대면적 FC-BGA 대응, 모델 체인지 시간 단축, OSP 공정 단순화, 맞춤형 CIM·SECS/GEM 지원으로 양산 경쟁력을 강화하며, dLSMB는 국책과제·산학협력을 통해 차세대 디스플레이/태양광 공정 장비의 선행개발과 공급 이력을 늘리고 있다.

세 제품군은 공정 단위가 아닌 라인/플랫폼 단위로 통합한다. 프로브 카드 전 공정(Probe Cutting → Pin Inserting → 기구 정렬·본딩 → Inspection → Micro-Repair)을 단일 셀로 구성하고 2D 스테이지 맵핑, 3D 오토포커스/다중 비전, 동축 카메라로 X·Y·Z 정렬과 위치 보정을 자동화한다. 레시피 기반 모듈화, 고속 본더, Vertical Pin Inserter, 인라인 옵션을 확보하고 공장 연동을 위해 CIM·SECS/GEM을 표준 지원한다. sLSMB는 레이저 솔더볼 제팅 헤드 기반으로 FC-BGA·WLP/FO 패키지 등 고집적 기판 대응을 확대하고, dLSMB는 FMM 리페어·태양광 스크라이빙으로 응용을 넓히고 있다.

■ 동사의 주력 기술 적용 제품

동사는 LSMB 자동화 장비를 자체 개발·제조하며, 반도체 테스트·패키징·디스플레이/태양광 전방 공정에서 요구되는 핵심 공정장비를 턴키로 공급하고 있다. pLSMB(Probe LSMB), sLSMB(Solder Ball LSMB), dLSMB(Display LSMB) 제품군을 축으로 레이저·광학, 초정밀 스테이지 모션 제어·보정, 3차원 비전 및 양산 자동화 공정 기술을 내재화한 것으로 확인된다.

그림 6. 동사 대표 기술제품 분야: 반도체 테스트(왼쪽) 및 반도체 패키징(오른쪽)



자료: 동사 IR자료(2023)

동사가 개발·공급하고 있는 대표 장비로는 [pLSMB] Laser Micro-Bonding System, High Speed Bonder, Probe Cutting System, Probe Inserting System, Wafer Inspection System, Laser Micro-Repair System(프로브 카드 전 공정 턴키), [sLSMB] Laser Bump Mounter, Laser Solder Ball Jet System(마이크로 범프 약 40~80 μ m 형성·리페어, WLP·BGA·LED·카메라 모듈 대응), [dLSMB] FMM Repair 및 대면적 박막 가공(스크라이빙·텍스처링·커팅) 장비가 있다. 국내는 직판 중심, 해외는 중국·일본·대만·베트남 등으로 수출을 병행하고 있으며, 주요 고객군은 기판 제조사, OSAT, IDM 등으로 확대하고 있다.

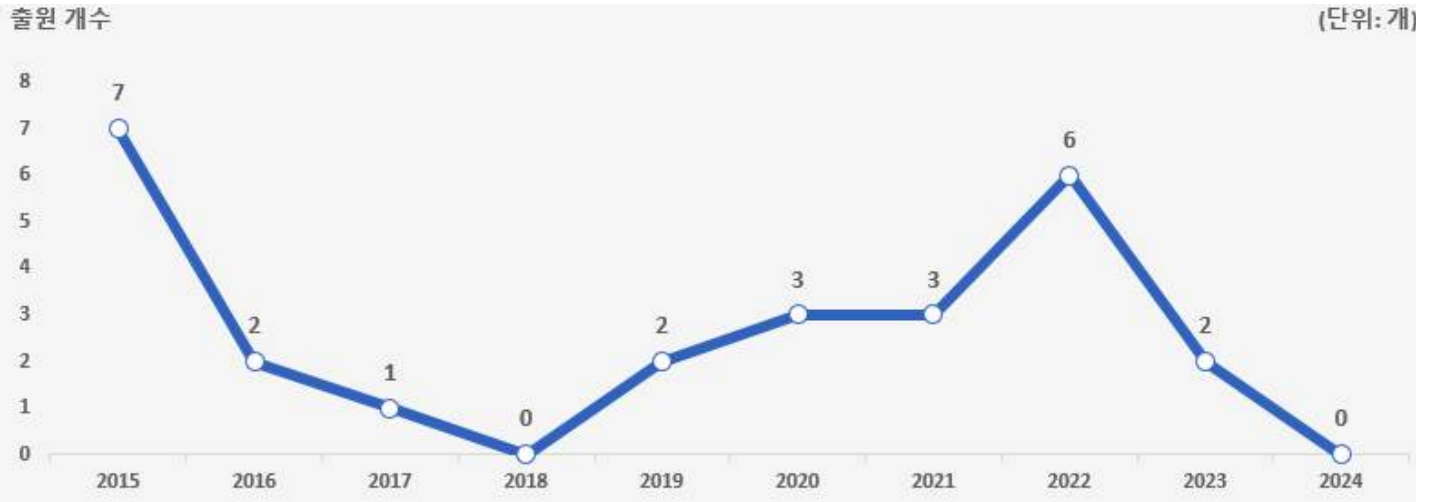
특히, 동사는 pLSMB 분야에서 다중 비전 기반 높이 산정·보정과 단계적 하강/재하강 로직을 레이저 본딩 공정에 적용해 본딩 정밀도와 수율을 높였다. 구체적으로, 프로브와 전극을 각각 복수 높이에서 촬영해 최적 초점 높이를 추출하고(높이 정보 산출), 표준 높이와 비교해 제2그리퍼(Z)를 자동 보정하며, 레이저 용융이 시작되면 재하강해 접촉·젖음성을 안정화하는 제어가 장비에 구현되어 있다(‘프로브 본딩장치 및 방법’ 등록특허 기반). sLSMB에서는 디스크형 안착홈 피더·검출센서·가스 가압·압력 연동 제어·틸팅 노즐을 결합한 레이저 솔더볼 제팅 구조를 통해 노즐 내 용융→분사 일체 공정으로 마이크로 범프(약 40~80 μ m) 형성 및 리페어를 고속·고정밀로 수행한다(‘솔더링(솔더볼 제팅) 장치’ 등록특허 기반). dLSMB는 FMM 리페어, 태양광 스크라이빙 등으로 응용 저변을 확대 중이다.

동사는 이러한 제품군을 바탕으로 프로브 카드 전 공정(Probe Cutting → Pin Inserting → 기구 정렬·본딩 → Wafer/Contact Inspection → Micro-Repair) 턴키 공급을 강화하고, 레시피 기반 모듈화·고속 본딩·3D 측정·Vertical Pin Inserter·인라인 옵션을 고도화하며, 공장 연동을 위해 맞춤형 CIM 및 SECS/GEM 지원을 제공하고 있다.

아울러 국내는 직판 중심으로, 해외는 직판과 대리점을 병행해 중국·일본·대만·베트남 등으로 수출을 확대하고 있으며, 샘플 테스트 장비를 통한 사전 검증 후 양산 장비 반복 주문(Repeat Order)를 유도하는 영업 모델과, 설치·유지보수·리페어·소모성 부품 공급 등 애프터서비스 체계를 운영하고 있다.

특허 활동 동향

KIPRIS(2025.08.14.)에 따르면, 당사는 총 35건의 특허를 출원, 27건이 등록(매입 1건 포함)되었다. 최근 10년 기준으로 26건의 특허를 출원, 22건이 등록(매입 1건 포함)되었다.



기술부문별 특허동향

최근 10년간 출원한 특허의 IPC코드를 통해 파악한 주요 기술부문은 [전기량측정], [이미지데이터처리], [반도체장치] 등으로 파악된다. (단, 기술부문별 최대 5건씩만 표시하였다.)

■ [G01R] 전기량측정

특허출원번호	발명의 명칭	출원일
1020230122384	프로브 본딩 장치용 그리퍼, 이를 포함하는 프로브 본딩 장치 및 이를 이용한 프로브 본딩 방법	2023-09-14
1020220086780	프로브 본딩장치 및 이를 이용한 프로브 본딩방법	2022-07-14
1020220086785	프로브 본딩장치 및 이를 이용한 프로브 본딩방법	2022-07-14
1020220086790	프로브 본딩장치	2022-07-14
1020220086794	프로브 본딩장치 및 이를 이용한 프로브 본딩방법	2022-07-14

■ [G06T] 이미지데이터처리

특허출원번호	발명의 명칭	출원일
1020210000627	타겟 패드 위치 측정 방법 및 이를 이용한 정밀 솔더링 방법	2021-01-05

■ [H01L] 반도체장치

특허출원번호	발명의 명칭	출원일
1020220142460	레이저 솔더링 장치 및 이를 이용한 레이저 솔더링 방법	2022-10-31

용어 정의

- 출원 특허: 특허를 받기 위해 심사를 요청한 상태
- 등록 특허: 심사를 통과해 법적으로 보호받는 특허
- 유효 특허: 현재 기준으로 유효하게 권리를 보호받을 수 있는 등록 특허
- IPC: 발명의 기술분야를 나타내는 국제적으로 통일된 특허분류체계

기술특허 빅데이터 분석(워드 클라우드)

워드 클라우드는 평가대상업체의 핵심 기술분야에서 특허 기술 키워드 변동을 보여주는 인포그래픽 분석 결과이다.

대상 기술분야의 최근 20년간의 특허 정보를 10년 단위로 비교하여 과거 대비 최근 이슈가 되고 있는 기술을 파악할 수 있는 것으로 기술분야 내 키워드 수가 많을수록 키워드의 크기가 크게 나타난다.

2005년 ~ 2014년



2015년 ~ 2024년



IV. 재무분석

매출액 및 이익의 전반적 상승 추이와 높은 실적 변동성

동사는 반도체와 디스플레이 장비 산업 속성상 매출과 영업이익 측면에서 높은 실적 변동성이 있으나 2024년 AI 및 HBM 반도체 업황의 활황으로 역대 최고 수준의 매출액 달성

■ 연도별/분기별로 높은 매출 변동성

전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 변동성으로 인해 동사의 연도별 매출과 이익 변동성이 대단히 높은 편으로, 동사 2023년 매출액은 전기 대비 3.1% 감소한 107억 원이었으나, 2024년 매출액은 AI 및 HBM 반도체 업황의 활황으로 187억 원에 달하였으며 역대 최고 수준을 기록하였다.

2024년 상반기와 2025년 상반기의 총 매출액은 각각 86억 원과 87억 원으로 전년 동기 대비 각각 91.1%와 1.7% 성장하였으며, 2025년 상반기는 2024년의 높은 실적에 따른 자연스러운 기저 효과 영향으로, 성장률은 다소 완만하게 나타났다.

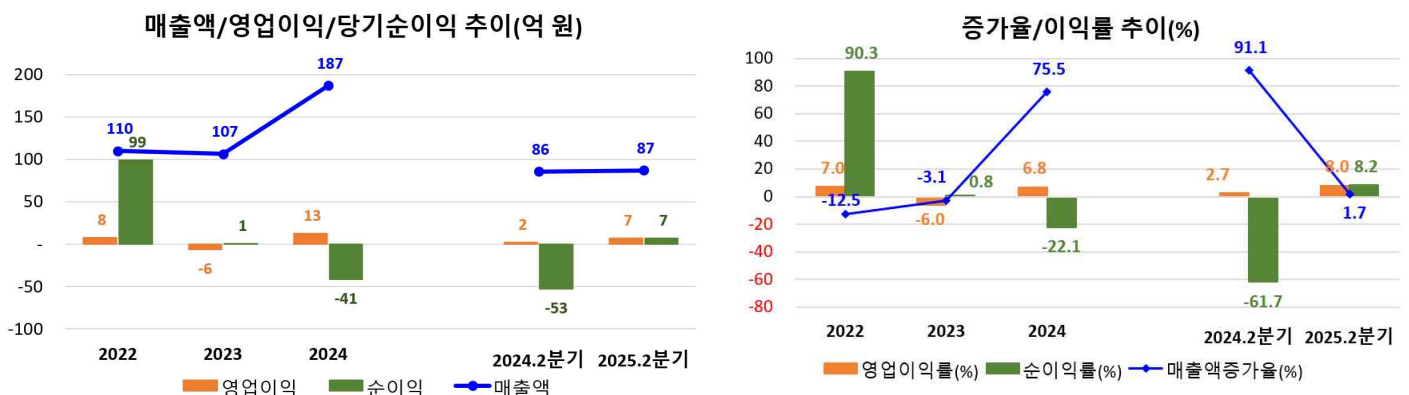
■ 매출과 핵심 원재료 단가의 변동성으로 인한 이익률 안정화 미흡

동사는 2022년 8억 원의 영업이익으로 7.0%의 영업이익률을 기록하였으나, 2023년 매출 감소 및 핵심 원재료 단가의 상승으로 6억 원의 영업적자로 반전되었다. 2024년의 경우 역대 최고 매출액과 함께 핵심 원재료 단가의 안정으로 영업이익 또한 13억 원의 역대 최고 실적을 시현하고 수익성 또한 회복하였다. 2025년 상반기의 경우 일부 주요 원재료 단가가 재상승하였으나, 지급수수료 등 판매비와관리비 절감으로 7억 원의 영업이익을 달성하였고, 영업이익률은 8.0%까지 상승하였다.

한편, 2022년 98억 원의 일시적인 파생상품 평가이익 발생으로 인하여 99억 원의 순이익을 달성하였으나, 2024년에는 52억 원의 합병비용으로 인하여 41억 원의 순손실을 기록하였다. 2025년 상반기의 경우 중요한 기타손익과 금융손익 발생이 없어 영업이익과 동일한 7억 원의 순이익을 시현하였다.

그림 7. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

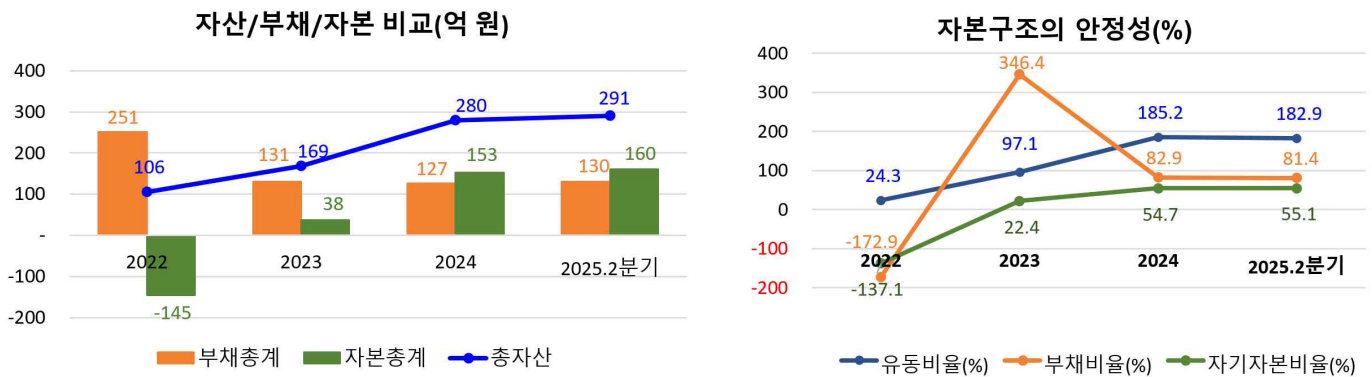
■ 스펙 합병 등을 통해 확보된 금융자산으로 재무안정성 개선

동사는 2022년 242억 원의 전기오류수정으로 자본총계는 완전자본잠식 상태에 이르렀으나, 2023년 상환전환우선주의 보통주 전환 182억 원과 2024년 합병으로 인한 자기자본 증가액 136억 원으로 2024년 말 자본총계는 153억 원으로 정상화, 총자산은 280억 원까지 증가하였다. 이에 따라 동사의 부채비율은 2023년 346.4%에서 2024년 82.9%로 안정화를 이루었으며, 유동비율 또한 2024년 185.2%까지 상승하였다.

동사는 2023년부터 매년 순이익 이상의 영업활동현금흐름을 창출하고 있으며, 상환전환우선주 전환 및 스펙합병을 통해 2024년 말과 2025년 상반기 말 현재 양호한 재무안정성을 보이고 있다.

그림 8. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

표 5. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 개별 기준)

항목	2022년	2023년	2024년	2024년 2분기	2025년 2분기
매출액	110	107	187	86	87
매출액증가율(%)	-12.5	-3.1	75.5	91.1	1.7
영업이익	8	-6	13	2	7
영업이익률(%)	7.0	-6.0	6.8	2.7	8.0
순이익	99	1	-41	-53	7
순이익률(%)	90.3	0.8	-22.1	-61.7	8.2
부채총계	251	131	127	107	130
자본총계	-145	38	153	130	160
총자산	106	169	280	236	291
유동비율(%)	24.3	97.1	185.2	218.1	182.9
부채비율(%)	-172.9	346.4	82.9	82.0	81.4
자기자본비율(%)	-137.1	22.4	54.7	54.9	55.1
영업활동현금흐름	-3	31	12	-29	-2
투자활동현금흐름	-2	-10	95	100	-7
재무활동현금흐름	2	-2	15	15	-1
기말의현금	18	37	160	123	150

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

■ 동사 실적 전망

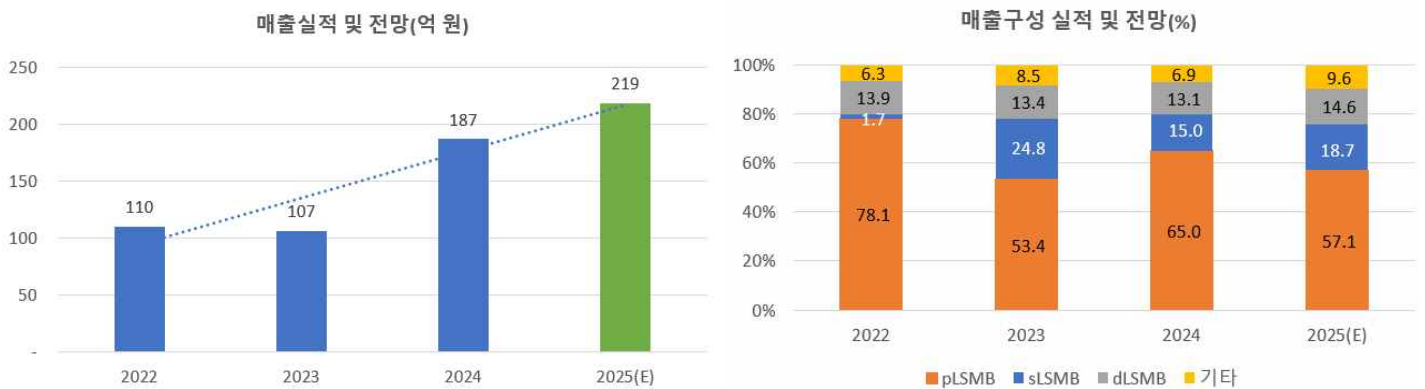
동사는 초정밀 마이크로 레이저 접합 장비 전문기업으로 반도체 초미세 접합공정에 필요한 원천기술 확보와 공정자동화 장비 제품 라인업 구축을 지속적으로 추진하였다.

동사가 참여 중인 pLSMB 제품과 관련한 프로브 카드 시장과 세계 반도체 패키징 장비 시장은 모바일 기기, 전기차 등 반도체 수요 증가와 반도체 미세화 및 패턴 고밀도화 등의 추세와 함께 견조한 성장이 전망된다. 또한, 동사는 반도체 시장 외에 첨단 디스플레이 및 차세대 Solar cell 시장을 중심으로 사업을 확대해 나갈 예정이며, 국내 반복 오더와 동아시아 중심의 해외 시장 개척을 통한 매출 신장을 계획 중이다.

과거 성장률 등을 고려 시 2025년 연간 매출액은 2024년 대비 약 17%의 매출 성장을 달성할 것으로 전망되며, 핵심 전방산업인 반도체 시장의 성장과 DRAM·HBM·NAND 수요 확대에 따른 장비 수요 증가, 동사 제품의 글로벌 AI 생태계 진입 현황, 신규 프로젝트 진행 및 수주 현황에 따라 그 이상의 실적 개선도 가능할 것으로 기대된다.

그림 9. 동사 매출전망 및 매출구성 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

표 6. 동사 품목군별 연간 실적 및 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 개별 기준)

항목	2022	2023	2024	2025(E)	2025.1Q	2025.2Q	2025.3Q (E)	2025.4Q (E)
매출액	110	107	187	219	27	60	36	96
pLSMB	86	58	121	125	12	47	7	59
sLSMB	2	26	28	41	-	6	18	17
dLSMB	15	14	25	32	11	4	8	9
기타	7	9	13	21	4	3	3	11

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

LSMB 통합 포트폴리오와 APAC으로 시장 확장

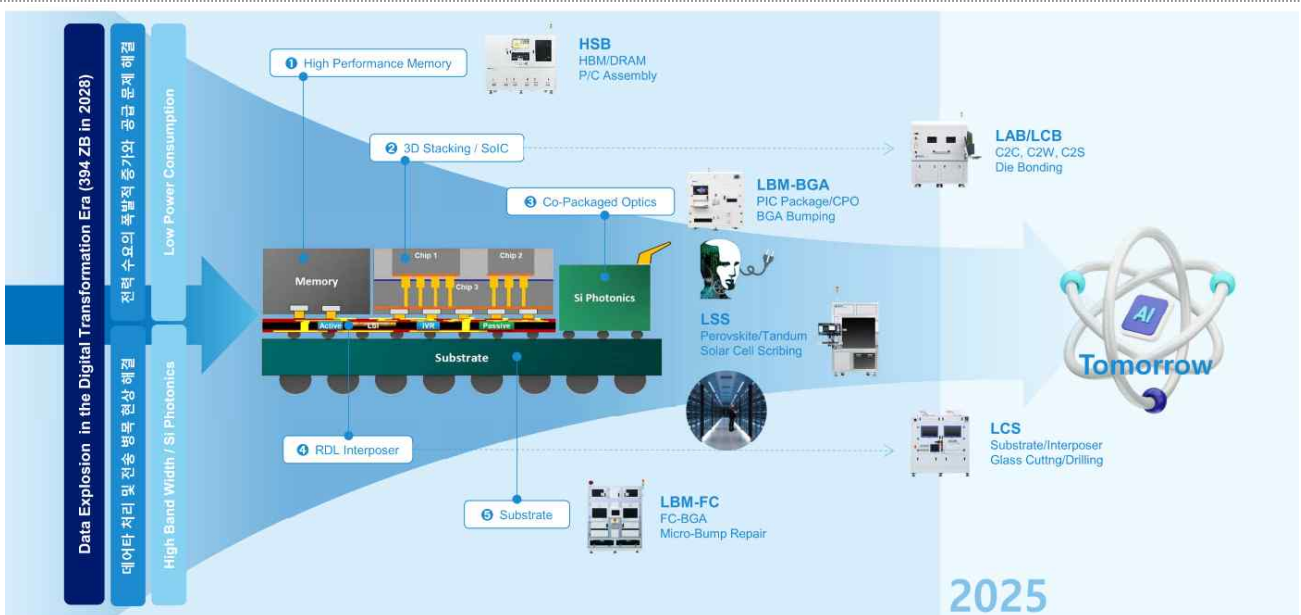
동사는 LSMB 기반 p/s/dLSMB 통합 라인업으로 다양한 분야의 핵심 응용을 커버하며, 테스트-패키징-소재 가공을 일관된 레시피와 모듈 구조로 연결한다. 중국·일본 선공략 후 대만·베트남으로 확장 중인 시장 전략과 데모·서비스 인프라의 단계적 구축, CIM-SECS/GEM 표준 제공을 통해 레퍼런스와 반복 수주를 확대하며 성장 중에 있다.

■ p/s/dLSMB 통합 포트폴리오: 메모리 적층부터 글라스 가공까지

동사는 LSMB(Laser Systemic Micro-Bonding)를 기반으로 데이터 폭증·저전력·고대역폭 수요에 대응하는 패키징·포토닉스·글래스 공정 라인업을 단계적으로 확장하고 있다. 2025 로드맵의 핵심 응용 축은 ① 고성능 메모리(HBM/DRAM), ② 3D Stacking/SoIC, ③ Co-Packaged Optics(실리콘 포토닉스), ④ RDL 인터포저, ⑤ Substrate로, 각 응용별 요구 공정에 맞춘 전용 장비를 제공한다.

고성능 메모리 영역에서는 HSB를 통해 HBM/DRAM 패키지 조립 공정을 지원한다. 3D 적층·SoIC 영역은 LAB/LCB로 C2C, C2W, C2S 다이 본딩을 커버하며, 포토닉스/광전 일체화(CPO) 영역은 LBM-BGA로 PIC 패키지·CPO용 BGA 범핑을 수행한다. Substrate 단계의 미세 접합 유지·수술 개선을 위해 LBM-FC로 FC-BGA 마이크로 범프 리페어를 제공하고, 소재·기관 가공 측면에서는 LCS로 서브스트레이트/인터포저용 글래스 커팅·드릴링, LSS로 페로브스카이트/탠덤 태양전지 스크라이빙을 제공해 디스플레이/태양광 응용까지 확장한다. 이들 장비군은 당사의 pLSMB·sLSMB·dLSMB 기술 축과 호환되는 레시피·모듈 구조를 갖추고 있어, 테스트-패키징-소재 가공 간 공정 연계를 일관되게 지원하고 있다.

그림 10. 첨단 공정 및 제품 고도화 로드맵



자료: 동사 기업설명회 자료(2025.06)

■ 고정상 해외 제조시장 타깃, 맞춤형 진입 전략 추진

동사는 3대 제품군(pLSMB · sLSMB · dLSMB)을 기반으로 중국 · 베트남을 1차 전략시장, 일본 · 대만 · 태국 등을 2차 확장시장으로 설정하고 글로벌 진출에 속도를 내고 있다. 중국 시장은 SUMEC-ITC와의 공급계약을 축으로 영업 · 설치 · A/S 응답성을 강화하여 pLSMB 중심 레퍼런스 확대하고 있으며, 일본 시장은 sLSMB 수요(솔더볼 제팅 · 마이크로 범프 형성 · 리페어)에 대응해 레퍼런스 확보하고 있다. 대만 · 베트남 시장은 기관사 · OSAT를 대상으로 pLSMB 턴키, sLSMB 리페어 수요 병행 공략 중에 있다.

최근 분기 수출은 주로 중국향이였으며, dLSMB(태양광 스크라이빙 · FMM 리페어)와 부품 공급으로 적용 범위를 넓히고 있다.

해외 신시장 개척 시 신규 고객에게는 사내 테스트 장비 기반 샘플 평가 · 성능 검증 후 양산 전환을 진행하고 있으며, 고객 설비 증설 주기에 맞춰 반복 수주 모델을 적용할 예정이다. 현지 서비스 인프라는 단계적으로 확충해 Raising Office → 현지 법인 → 브랜치(중국 · 대만 · 베트남 · 일본 · 미국) 순으로 확대하고 있으며, 해외 고객사의 기술 검증을 위해 데모 장비 현지 배치를 검토하며, 내수 · 수출 대응력 강화를 위해 클린룸 포함 공장 증설도 계획하고 있다.

장비 통합 · 라인 인라인화 및 공장 연동을 위해 맞춤형 CIM · SECS/GEM 지원을 표준 옵션으로 제공, 레시피 기반 모듈화 · 고속 본더 · 3D 측정 · Vertical Pin Inserter · 인라인 옵션 등 고객 맞춤 엔지니어링을 강화할 예정이다.

국내 주요 고객사 납품 · 반복 수주를 기반으로 중국 pLSMB와 일본 sLSMB 확대를 양 축으로 수주 파이프라인을 늘리고, 제품 포트폴리오(테스트→패키징→디스플레이/태양광)와 지역 다변화를 병행해 연간 성장 목표를 달성할 계획이다.

그림 11. 핵심 솔루션 공급 기반 해외 진출 가속화 전략



자료: 동사 기업설명회 자료(2025.06)

다원넥스뷰(323350)

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
-	-	-	-
투자의견 없음			

시장정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2025.08.21.)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
다원넥스뷰	X	X	X